公司代码:688627　　公司简称:精智达

深圳精智达技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中相关内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025 年度,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.24 元(含税)。截止 2026 年 4 月 9 日,公司总股本 94,011,754 股,扣除公司回购专用账户中股份总数为 211,477 股后的股本 93,800,277 股为基数,以此计算拟派发现金红利总额为人民币 21,011,262.05 元(含税)。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 32.12%。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

上述利润分配方案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	精智达	688627	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭娟	黄琳惠
联系地址	深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司 1 号 101 工业园 D 栋 1 楼东	深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司 1 号 101 工业园 D 栋 1 楼东
电话	0755-21058357	0755-21058357
传真		
电子信箱	jzd@seichitech.com	jzd@seichitech.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

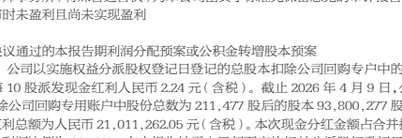
公司作为专注于半导体测试检测设备及系统解决方案的创新企业,以实现关键设备自主可控为核心目标,着力构建系统化全站点服务能力。秉持“不断提供最优质的产品和服务、坚持技术创新、创造价值以助力社会进步”的企业使命,公司聚焦技术创新,持续深耕半导体行业需求。

1、半导体测试解决方案

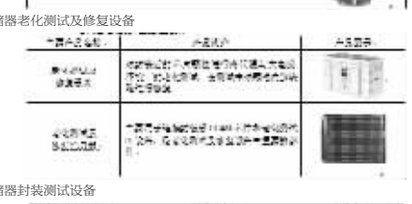
公司的半导体测试方案主要面向 DRAM 等存储器领域,覆盖晶圆制造环节的裸片电性能与功能测试,以及封装测试环节的芯片颗粒电参数测试、功能测试、老化及修复,确保产品符合设计规范。此外,公司还推出了算力芯片测试设备,旨在提升 SoC 芯片的测试效率与精度、降低测试成本,进一步丰富产品布局。

公司的半导体存储器件测试解决方案涵盖晶圆测试设备、老化测试及修复设备、FT 测试机、MEMS 探针卡及其他测试配件。主要产品如下:

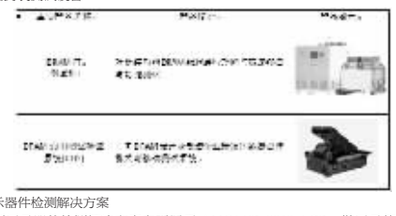
(1)存储器晶圆测试设备



(2)存储器老化测试及修复设备



(3)存储器封装测试设备

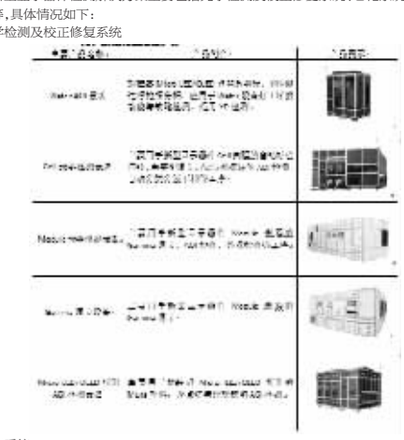


2、新型显示器件检测解决方案

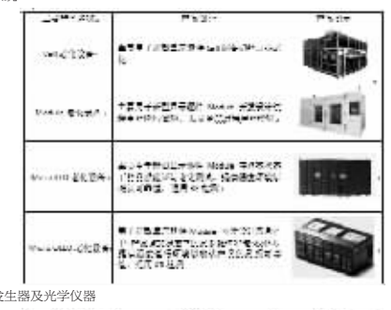
公司的新型显示器件检测解决方案主要用于 AMOLED、TFT-LCD、微显示等新型显示器件的 Cell 与 Module 制程的光学特性、显示缺陷、电学特性等各种功能检测及校准修复,用于产品缺陷检测、产品等级判定与分类,对部分产品缺陷进行校准、修复及复判,从而提升产品良率、降低生产损耗,并为相关工序的工艺提升提供数据支撑。

公司的新型显示器件检测解决方案主要包括光学检测及校正修复系统、老化系统、信号发生器及检测系统配件等,具体情况如下:

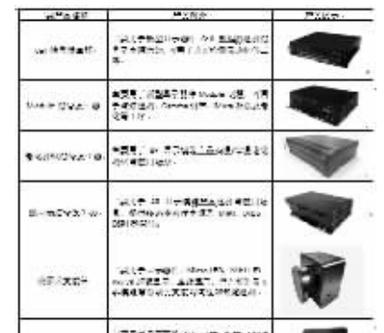
(1)光学检测及校正修复系统



(2)老化系统



(3)信号发生器及光学仪器



(4)检测系统配件

检测系统配件主要包括检测治具、检测耗材及其他辅助设备等。

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

公司通过向下游半导体存储和新型显示制造厂商销售设备、配件或提供服务实现收入和利润。报告期内,公司主营业务收入来源于设备及配件的销售等,其他业务收入来源于设备维护服务等。

2、研发模式

公司严格践行“量产一代、在研一代、预研一代”的阶梯式可持续研发节奏,构建产业化落地与技术迭代双向赋能的良性循环,从而保障业务的持续拓展,并为长期发展奠定坚实基础。公司研发团队密切关注及学习半导体存储器件及新型显示器件行业的先进技术,及时把握下游行业发展动向和产品革新信息,设定前瞻式研发计划,针对潜在目标市场提前进行技术储备。同时,公司研发团队基于不同的项目特点,进行需求细化和技术分析,结合公司已有的研发成果,组织研发力量进行技术开发及产品交付,在项目完成后将技术成果模块化、固定化,便于后续其他项目与产品研发重复使用与调取。通过市场与研发的衔接,公司的研发工作持续输出,确保在技术上的可行性和经济收益上的稳定性,有效提高研发效率,降低研发风险。

3、采购模式

公司主要根据产品销售订单设计参数并出具物料清单,制定原材料采购计划。对于部分交货期较长的核心原材料,公司根据市场情况进行适量备货,以及时响应客户需求。公司综合考虑产品质量、采购价格、订单交期、售后服务及合作关系的稳定性等因素选择供应商,已与主要供应商建立了长期且稳定的合作关系。

4、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式,根据客户对所需产品的性能、规格、配置的要求进行定制化生产。公司产品生产严格遵循研发定型的硬件图纸与工艺说明,经过物料采购、硬件装配、软件安装、系统调试等一系列生产流程控制和严格的质量检验,最终交付客户合格的产品。

5、销售模式

公司采用直销模式,产品主要向下游客户直接销售,通过商业谈判或招投标方式获取订单。公司与产业下游主流厂商建立了稳定的合作关系,深入了解客户需求,不断完善产品和服务,增加市场份额和品牌知名度。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展阶段

半导体产业是信息技术产业及现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,其发展水平是衡量国家或地区综合竞争力的重要标志。半导体设备作为半导体产业的核心支撑与关键驱动力,近年来持续获得国家层面政策的密集扶持,行业已进入关键核心技术攻关与产业化落地的战略突破阶段。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》将“加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力”作为核心任务,明确强调在集成电路等重点领域推动关键核心技术取得决定性突破,并强化企业科技创新主体地位。具体政策如下:

序号	时间	发文部门	法律法规及政策	主要内容
1	2026年 3 月	中共中央	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节,采取超常规措施,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。
2	2025年 8 月	工信部、市监总局	《电子信息制造业 2025 — 2026 年稳增长行动方案》	坚定不移推动“国货国用”,持续推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链……强化计算等领域芯片、零部件、整机系统等研发应用和配套适配。
3	2024年 7 月	中国共产党二十届三中全会	《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》	抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制,全链条推进技术攻关、成果应用。
4	2023年 2 月	工信部等七部门	《智能检测装备产业发展行动计划(2023 — 2025 年)》	供给能力提升重点方向:关于电子行业方面,突破电性能测试系统、高精度探针台等。
5	2023年 12 月	国家发改委	《产业结构调整指导目录(2024 年本)》	将球栅阵列封装(BGA)、插针网格阵列封装(PGA)、芯片规模封装(CSP)、多芯片封装(MCM)、栅格阵列封装(LGA)、系统级封装(SIP)、倒装封装(FC)、扇出级封装(WLP)、传感器封装(MEMS)、2.5D、3D 等一种或多种技术集成的先进封装与测试,集成电路装备及关键零部件制造,Mini/Micro LED 显示等新型显示器件生产及专用设备列为鼓励类产业。
6	2021年 12 月	财政部等五部门	《国家支持发展的重大技术装备和产品目录(2021 年修订)》	集成电路自动化测试及分选设备属于国家支持发展的重大技术装备和产品。

综上,在政策层面,国家“十五五”规划顶层设计与细分领域专项行动方案相互衔接、协同发力,共同构建了覆盖全维度、多层次的政策支撑体系。该政策体系不仅为我国半导体测试检测设备行业高质量发展筑牢了坚实基础,更有效推动行业加速实现从“技术追赶”向“自主创新”的战略转型,为行业内企业发展提供了明确的政策指引和有力的政策保障。

政策引导与市场需求的双重驱动下,我国半导体测试设备行业正处于技术迭代加速、市场规模持续扩容的关键发展阶段,行业整体呈现稳步向好的发展态势。但从行业竞争格局来看,高端市场仍由国际龙头企业主导,以核心设备测试机为例,2024 年国外前两大厂商在中国大陆市场的合计占有率高达 80%,高端领域国产化率处于较低水平。随着本土企业在核心技术领域的持续突破(如部分测试设备已实现从 0 到 1 的验证与导入),本土半导体测试检测设备厂商在高端市场具备巨大的突破潜力,行业正迎来关键窗口期。

与此同时,下游应用场景的持续爆发为行业发展创造了全新的增长极。在人工智能与新型人机交互浪潮的驱动下,Micro LED 等微显示技术加速落地应用,行业产业化进程不断推进。XR 作为下一代信息交互的核心载体,其终端市场呈现快速增长态势,据 CINNO Research 相关数据,2025 年国内消费级 AI/AR 市场销量同比激增 109%。在此发展进程中,XR 检测设备作为提升相关产品良率、降低制造成本的核心支撑,其市场需求有望迎来快速放量,成为半导体测试检测设备行业重要的新增量,为行业内企业带来广阔的市场发展空间。

(2)行业基本特点

半导体测试检测设备行业具有技术壁垒高、资金投入大、与下游产业链协同性强的显著特征。随着芯片技术加速迭代与应用场景持续拓展,行业竞争逻辑深刻重塑,主要呈现以下特点:

一是技术迭代与产品升级强劲定。半导体测试设备的技术迭代速度与芯片制程升级、架构创新高度同步,随着芯片向先进制程演进,功能日趋复杂,应用方面向 AI 芯片、车规芯片等复杂场景延伸,对测试功能和指标不断提出新的要求,因此测试设备需要不断升级,研发工作的介入点大幅前移至前期工程验证阶段(即“左移”),企业需持续加大研发投入,以快速匹配新型芯片的测试需求。同时,随着 AMOLED、XR 显示、Micro LED 等显示技术的快速迭代,检测设备需同步升级检测精度、响应速度与多场景适配能力,适配不同显示面板的分辨率、像素尺寸、刷新率、亮度等核心参数,并紧跟新型显示技术推广节奏,快速完成产品迭代,满足下游产线的良率管控与性能检测需求。

二是资金密集型与技术密集型属性显著。本行业为知识和技术密集型行业,产品研发涉及电子电路设计、精密光学、精密机械设计与自动化控制,以及软件算法等多学科、多领域知识的综合运用,具有较高的技术和客户验证壁垒。国外龙头设备厂商通过长期大规模的研发投入,以此保持产品技术优势并巩固行业领先地位。本行业亦具有显著的资金密集型特征,技术研发、生产运营及配套服务均需要大量且持续的资本投入。

三是产业链协同性强,深度绑定下游客户。半导体测试设备与下游客户深度协同,产业链协同深度直接决定客户黏性与市场竞争力。AMOLED、XR 检测设备亦然,需在产线建设初期嵌入关键工艺节点,与工艺设备协同推动良率爬坡与产能释放,是产线闭环控制的核心环节。

四是需求分化明显,高端场景驱动增长。当前 AI 芯片、车规芯片、HBM 存储芯片等高端场景,对测试设备的功能、精度、速度、最大并测数以及可靠性均提出极高要求,需求爆发式增长;随着 XR 终端加速渗透,以 Micro LED 为代表的微显示技术受到广泛关注,检测设备作为提升良率、降本增效的关键支撑,需求有望逐步放量。应用场景的迭代升级,仍是行业需求增长的核心驱动力。

(3)主要技术门槛

半导体测试检测设备的技术门槛贯穿研发、生产、适配全环节,其核心壁垒可归纳为以下主要维度,构成行业准入的核心障碍,也是本土企业实现技术突破的关键瓶颈。

第一,高速测试技术壁垒。随着 HBM、算力芯片及先进封装等新兴技术的快速发展,市场对半导体测试设备的测试速率提出了更高要求,高速化已成为行业核心演进方向,也是重要的技术壁垒。AI 技术对高性能算力、高密度存储的极致诉求,叠加其在智能驾驶、云计算、边缘计算等新兴场景的广泛应用落地,持续驱动半导体产业链上下游加速技术迭代、产品升级与制程革新,以算力芯片、HBM 为代表的高端芯片测试需求显著提升。这类高端芯片的性能验证,对测试设备的信号传输速率、同步精度等核心指标提出严苛标准,在前沿技术不断迭代的同时,也为半导体测试设备厂商的技术升级带来巨大挑战,进一步强化了高速测试技术的壁垒属性。

第二,核心零部件制备壁垒。半导体测试设备的核心零部件包括高精度传感器、专用 ASIC 芯片、高速信号处理器、精密连接器等。其中,专用 ASIC 芯片需满足高带宽、低延迟的测试需求,是测试设备的核心部件,其设计涉及数模混合信号处理,技术复杂度远高于通用芯片。核心零部件的制备技术高度集中于少数海外企业,本土企业面临供应链安全风险,零部件进口依赖度较高。同时,核心零部件的稳定性直接决定测试设备的整体可靠性,进一步拍升了生产端的技术门槛。此外,在晶圆测试环节,探针卡(尤其是 MEMS 探针卡)作为连接晶圆与测试机的关键部件,其在高低温环境下的形变控制能力与微小信号传输性能,同样是重要的技术壁垒。

第三,客户认证与海外头部友商生态壁垒。半导体测试设备直接影响芯片成品的质量与良率,下游芯片企业对设备的可靠性、稳定性要求极为严格。设备投入产线后需经过长期、大规模的量产验证,方能获得客户认可。这一验证周期不仅关乎客户信任的建立,更是对设备极限性能的检验:设备必须在海量芯片的测试过程中保持极低的误判率,任何偏差均可能显著增加半导体厂商的测试成本。海外头部企业凭借长期的技术积累与客户资源,已形成成熟的验证体系与客户信任,构建了从研发验证到量产应用的完整生态闭环。本土企业即便在技术上实现突破,仍需经历较长的客户验证周期,短期内难以大规模切入高端市场。

第四,光学检测技术壁垒。随着显示技术与先进封装的融合发展,OLED、Micro LED 及 XR 微显示器件对光学检测提出更高要求。光学检测设备需集成高分辨率成像系统、光谱分析模块及精密运动控制平台,以完成亚微米级缺陷检测、亮度色度测量计算以及 Mura 判定与修复。其技术难点主要体现在:显示器件本身发光效果与效率变化的问题、光学串扰的问题、高色纯显示器件的色彩还原与测量问题,以及高 NA 光学系姿态调整的问题。光学检测算法需结合运动控制、环境控制等多个工程领域,协同完成显示器件的精密量测与检测。目前,高端光学检测核心部件(如高灵敏度相机、高 NA 光学系)及算法软件仍由国外企业占据主导地位。能够系统掌握上述关键技术、实现核心部件与算法自主可控的企业,将在高端光学检测领域构筑起显著的技术壁垒与竞争优势。

总体来看,上述技术壁垒共同构成了半导体测试检测设备行业的高准入门槛。本土企业需在高速测试技术、核心零部件突破、客户验证体系建设以及前沿光学检测技术等方面协同发力,方能逐步缩小与海外龙头的差距,提升在高端市场的竞争力。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

在人工智能加速产业创新、半导体产业国内自主突破的时代背景下,公司以打造半导体测试检测设备平台型企业为战略目标,以测试检测技术为核心入口、以人工智能为关键驱动力,持续深化技术创新与产业应用融合,不断完善多场景系统化解决方案能力,稳步提升在产业链中的战略地位与行业影响力。

依托在半导体存储测试领域多年深耕与自主创新,公司已形成覆盖半导体存储器测试领域关键设备与配套治具的完整产品线,主要包括晶圆测试设备、老化测试及修复设备、FT 测试机、MEMS 探针卡及其他测试配件等,是国内少数实现半导体存储器测试设备全覆盖的厂商。相关产品已在多条产线实现对国外供应商的替代,成为客户相关产品主要供应商,助力关键生产环节自主突破。

公司坚持自主研发,核心技术自主突破,在海量通道高速信号连接、高精度时序信号生成及驱动、DRAM 测试及修复算法、宽温区高均匀度老化控制等关键领域形成深厚技术积累。公司在高速芯片测试领域取得关键突破,报告期内,公司向客户交付首台自主研发的 9 Gbps 高速 FT 测试机,同时稳步推进 18 Gbps 高速 FT 测试机项目。目前半导体存储测试设备核心产品线多项关键性能指标已达国际先进水平,为公司参与高端测试设备市场竞争奠定了坚实的技术基础与核心能力。

公司与国内头部半导体存储厂商、新型显示制造厂商建立长期稳定的深度合作关系,核心产品规模化应用于国内头部厂商生产线。其中老化测试修复设备、探针卡等产品成功实现进口替代,成为国内头部半导体存储厂商主力供应商,报告期内市场占有率持续提升。

在 AI 加速产业创新、半导体产业国内自主可控的时代背景下,公司以打造半导体测试设备平台型企业为战略目标,以测试检测技术为核心入口、以 AI 为关键驱动力,持续深化技术创新与产业应用融合,将不断完善多场景系统化解决方案能力,稳步提升在产业链中的战略地位与行业影响力。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内,以人工智能为核心的新一代信息技术正深刻重塑全球半导体产业格局。AI 生态的持续完善驱动算力需求稳步攀升,叠加 HPC、XR 等下游应用对芯片性能提出的更高要求,推动半导体产业在算力供给、存储带宽、显示精度等核心维度发生结构性变革。当前,半导体产业正逐步进入由 AI 算力基础设施、先进逻辑芯片、先进封装技术与高端存储器件共同驱动的新一轮上行周期。

半导体产业上行周期的发展态势,直接带动了半导体测试设备销售的增长。据 SEMI 统计,2025 年全球半导体测试设备销售额预计同比增长 48.1%,且 2026 年至 2027 年将延续增长态势。半导体测试设备行业龙头企业基于对全球半导体测试设备行业及下游核心需求的深度研判,表示尽管市场存在对 AI 投资节奏波动的担忧,但领先 AI 芯片、定制 ASIC 及高端存储器件的投资仍将持续推进。此类器件的研发生产对测试设备的高端化、精细化需求显著,将持续拉动半导体测试设备市场需求。同时,随着芯片器件复杂度提升、芯片单价上涨,下游客户为保障产品良率、性能及质量,将增加测试时间、优化测试流程、丰富测试内容。半导体测试环节已不再单纯属于成本项,而是逐步成为提升产品良率与质量的“价值创造环节”,进一步凸显半导体测试设备的核心价值。

旺盛的市场需求直接传导至供给端,驱动全球晶圆厂产能加速扩张。与销售数据相呼应,全球晶圆厂产能扩张持续提速。据 SEMI 预测,到 2030 年,全球晶圆产能总量将从 2020 年的 2510 万片 / 月提升至 4450 万片 / 月,其中中国产能总量将从 2020 年的 490 万片 / 月增至 1410 万片 / 月,市场份额从 20% 提升至 32%。随着晶圆产能持续增长,晶圆厂扩建步伐同步加快,预计 2028 年全球新建晶圆厂中,中国将独占 47 座,占亚洲新增产能的一半以上,成为全球产能扩张的核心区域。

产能扩张伴随而来的是供需格局的深刻重塑,传统周期波动已被结构性紧平衡取代。同时,产业价格格局与周期特征亦发生显著变化。受 AI 服务器对 HBM、服务器 DRAM 及企业级 SSD 需求快速提升的影响,全球存储产业已由传统周期波动逐步演化为“AI 需求驱动下的结构性紧平衡”格局。TrendForce 数据显示,2026 年一季度常规 DRAM 及 NAND Flash 价格均出现大幅上行,行业供需关系显著收紧。与此同时,全球主要存储厂商正将更多先进制程和新增产能优先投向 HBM 及高端服务器存储产品,并纷纷公布相应扩产计划,进一步强化结构性紧平衡的发展态势。这一格局变化直接利好具备高端测试能力的设备厂商。

从技术迭代角度看,AI 对高性能算力与高密度存力的极致诉求,推动算力芯片、高带宽存储(HBM)等高端芯片需求激增。此类芯片功能复杂、数据吞吐量大,导致测试环节面临两大核心难题:一是测试内容趋于复杂,需应对庞大数据流与多维度算法验证;二是测试速度必须提升,以匹配 HBM、先进封装等新兴技术的迭代节奏。上述供需矛盾直接转化为高端测试设备的刚性市场需求。

与此同时,随着摩尔定律逼近物理极限,2.5D/3D 封装、Chiplet 等先进封装成为延续性能提升的关键路径。芯片结构从平面走向立体,对测试设备的信号精度、多通道协同能力提出严苛要求。以 HBM 为例,其高密度垂直堆叠结构不仅驱动测试设备向更高精度、更强并行能力迭代,更从根本上改变测试逻辑——测试模式从“抽样测试”转向“全深度测试”,测试时间大幅延长,为存储测试设备带来技术升级与测试密度提升的双重结构性增长机会。

为应对上述挑战,半导体测试设备目身正经历深刻的技术迭代,主要体现在测试速度、平台化集成与智能化三大核心方向的加速演进。测试速度方面,面向 AI 算力芯片、高端存储芯片、先进 SoC 芯片等产品,测试设备正加速向高通道数、高信号速率、高并行度方向演进,以满足高速传输、低时延、高可靠性的严苛测试要求。平台化集成方面,行业主流技术路径已转向通用化、模块化软硬件架构,通过同一平台兼容多品类芯片测试,有效降低客户产线改造成本、提升测试适配效率。智能化方面,AI 算法与大数据分析正深度融入测试流程,推动测试设备从“被动检测”向“主动预判”升级,通过实时数据分析实现测试参数动态优化与良率预警,显著提升测试效率与产品良率。上述技术方向的深度演进,正成为半导体测试设备构筑核心竞争力的关键支撑。

在人机交互领域,XR 等新兴设备的崛起为微显示技术带来产业化提速机遇。微显示技术向高分辨率、高对比度方向持续演进,要求相关企业将 AI 算法与数据分析深度融入检测方案。XR 及智能眼镜的快速发展正驱动 Micro OLED/LED 加速产业化,据 IDC 2024 年发布的数据预测,2024 年至 2029 年全球 AR/VR 市场规模复合增长率达 21.1%,其中中国市场以 41.4% 的增速成为全球增长极,为国产微显示检测设备厂商创造显著增量空间。

综上,本轮半导体测试检测设备市场增长的核心驱动力,源于下游应用对芯片性能的极致追求与芯片制造工艺向物理极限的持续探索。两者共同作用,使测试设备的精度、速度与并行处理能力成为制约芯片量产的关键瓶颈,推动市场规模持续扩张。在此背景下,能够紧跟技术迭代、在精度与速度等核心指标上实现突破的本土厂商,有望在国产化替代进程加速中充分受益。公司所处的半导体测试设备环节,兼具“新增产能导入”与“测试复杂度提升”双重驱动,未来在存储、算力、先进封装及国产替代等多重趋势叠加下,预计将迎来持续扩大的市场空间和发展机遇。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,345,441,630.53	2,030,354,809.18	15.52	1,996,487,508.09
归属于上市公司股东的净资产	1,723,144,422.70	1,721,973,056.36	0.07	1,719,227,487.47
营业收入	1,128,061,120.07	803,129,707.64	40.46	648,563,325.45
利润总额	67,382,310.27	73,542,244.99	-8.38	129,543,657.61
归属于上市公司股东的净利润	65,421,196.82	80,160,244.51	-18.39	115,684,848.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,878,970.42	68,855,656.78	-14.49	84,346,700.88
经营活动产生的现金流量净额	105,333,229.97	14,564,741.84	623.21	-13,548,051.46
加权平均净资产收益率(%)	3.80	4.66	减少 0.86 个百分点	10.71
基本每股收益(元/股)	0.7024	0.8562	-17.96	1.4406
稀释每股收益(元/股)	0.7015	0.8562	-18.07	1.4406
研发投入占营业收入的比例(%)	16.23	13.66	增加 2.57 个百分点	11.08

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	152,111,547.64	291,517,964.90	309,410,485.42	375,021,122.11
归属于上市公司股东的净利润	-16,215,794.47	46,802,768.72	10,882,103.72	23,952,118.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,029,837.37	45,412,077.32	10,382,022.82	21,114,707.65
经营活动产生的现金流量净额	-13,562,138.68	-53,407,392.20	43,072,759.09	129,230,001.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,788
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,495
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张滨	0	17,474,715	18.59	17,474,715	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,904,344	3,451,058	3.67	0	无	0	境外法人
中信银行股份有限公司-永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金	2,600,000	2,600,000	2.77	0	无	0	其他
深圳市萊通投资合伙企业(有限合伙)	0	2,410,040	2.56	0	无	0	其他
深圳国中创业投资管理有限公司-深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-3,176,547	2,054,355	2.19	0	无	0	其他
深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙)	-3,046,720	2,000,000	2.13	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	1,877,092	1,877,092	2.00	0	无	0	其他
深圳源创力清源创业投资合伙企业(有限合伙)	-276,623	1,813,246	1.93	0	无	0	其他
深圳市丰利莱投资合伙企业(有限合伙)	0	1,775,311	1.89	0	无	0	其他
深圳市睿通达投资合伙企业(有限合伙)	0	1,625,000	1.73	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		深圳萊通、深圳丰利莱为公司员工持股平台,张滨担任深圳萊通、深圳丰利莱执行事务合伙人,系一致行动人。源创力清源、常州清源、新麟二期的执行事务合伙人及管理人同受深圳清源创业投资管理控股有限公司控制,互为一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

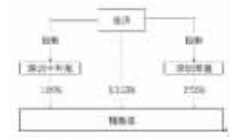
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

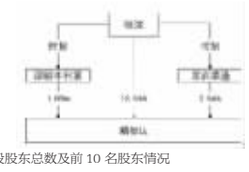
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 112,806.11 万元,同比增长 40.46 %;归属于上市公司股东的净利润 6,542.12 万元,同比下降 18.39%。截至报告期末,公司资产总额 234,544.16 万元,归属于上市公司股东的净资产 172,314.44 万元,财务状况稳健。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688627　证券简称:精智达　公告编号:2026-032

深圳精智达技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”或“精智达”)于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑目前募集资金投资项目的实施进度等因素,同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“新一代显示器件检测设备研发项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2028 年 2 月。保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了无异议的核查意见。上述事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 26 日出具的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1170 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,350.2939 万股,每股发行价格为人民币 46.77 元,募集资金总额为人民币 109,923.25 万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 11,266.79 万元后,募集资金净额为人民币 98,656.46 万元。

上述募集资金已于 2023 年 7 月 13 日全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了“大华验字[2023]000414 号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2026 年 2 月 28 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后拟使用募集资金金额	已累计投入募集资金总额	募集资金投入进度(%)
1	新一代显示器件检测设备研发项目	19,800.00	19,800.00	8,647.37	43.67
2	新一代半导体存储器件测试设备研发项目	16,200.00	16,200.00	16,266.27	100.42
3	补充流动资金	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00
4	超募资金用于先进封装设备研发项目	不适用	29,960.74	10,704.20	35.73
5	超募资金用于补充流动资金	不适用	8,696.72	10,639.38	122.35
合计		60,000.00	98,656.46	70,257.22	71.21

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因延期原因

(一)本次部分募集资金投资项目延期的基本情况

在结合考虑当前宏观经济环境、新型显示行业发展状况及公司实际投资进度和建设情况等背景下,经过综合分析与审慎评估,公司决定在项目实施主体、募集资金投资用途及规模均不发生变更的情况下,将“新一代显示器件检测设备研发项目”达到预定可使用状态时间延期至 2028 年 2 月。

单位:人民币万元

	本次调整前			本次调整后		
序号	项目名称	募集资金投资额	项目达到预定可使用状态日期	项目名称	募集资金投资额	项目达到预定可使用状态日期
1	新一代显示器件检测设备研发项目	19,800.00	2026年 8 月	新一代显示器件检测设备研发项目	19,800.00	2028年 2 月

(二)本次部分募集资金投资项目延期的具体原因

自募集资金到位以来,公司稳步推进“新一代显示器件检测设备研发项目”建设,审慎规划募集资金的使用。鉴于 AMOLED、大尺寸超高清等新型显示技术的整体商业化进程及发展节奏慢于行业预期,且行业内蒸镀、ViP、印刷 OLED 等多元技术路径仍处于并行发展期,尚未完全收敛等因素的综合影响,为保障募投项目的投资有效性,公司基于当下所处的市场环境和技术发展趋势,对项目实施节奏进行了适当调整,致使相应的建设进度周期较原计划有所延长。

为维护公司及全体股东利益,充分考虑募投项目建设周期与资金使用情况,经审慎的研究论证,公司决定将“新一代显示器件检测设备研发项目”达到预定可使用状态时间调整至 2028 年 2 月。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

五、履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“新一代显示器件检测设备研发项目”达到预定可使用状态的时间延期,延期至 2028 年 2 月。保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

本次新一代显示器件检测设备研发项目延期事项已经公司董事会审议通过,符合《证券发行上市保荐业务管理办法